复旦大学有源硅中介层芯片封装加工服务（第二次）公开招标失败公告

2026年11月13日 10:37 来源：中国政府采购网 【打印】 【显示公告概要】

一、项目基本情况

采购项目编号：FW2026090901

采购项目名称：复旦大学有源硅中介层芯片封装加工服务

二、项目废标/流标的原因

本项目通过资格性审查的供应商不满三家，本次招标失败。

三、其他补充事宜

在此，对积极参与本项目投标的供应商表示衷心的感谢。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：复旦大学

地址：中国上海市杨浦区邯郸路220号

联系方式：李老师 86-21-65641327

2.采购代理机构信息

名 称：上海政采项目管理有限公司

地　址：上海市静安区天目中路383号10楼

联系方式：王一澄、孙健峰 021-62091273-8003，15921879725

3.项目联系方式

项目联系人：王一澄、孙健峰

电　话：　　86-21-62091273*8003，15921879725

政府网站找错
党政机关

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈